



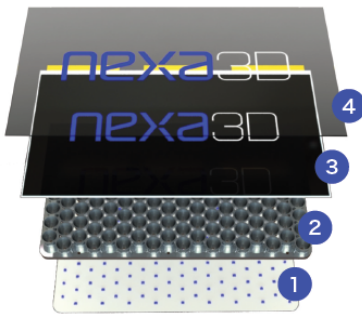
nexa3D® NXE400

Upgrade. Additive. Manufacturing.

商品紹介

Nexa3D社のNXE400プリンターは、独自の潤滑剤サブレイヤー光硬化(LSPc)技術によって超高速プリントを実現するインダストリアル向け光造形プリンターです。次世代型プリンターNXE400はその驚くべきスピードで様々な業界に革新を起こします。

インダストリアルレベルに到達する驚異の3Dプリンティング



LSPc技術

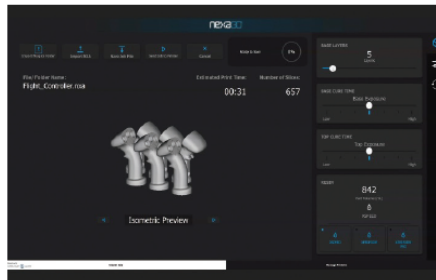
独自のLSPc技術の基本は、紫外線(UV)列とLSPc光層の組み合わせによって形成される均一な光源です。次に、均一な光源はLSPc HCマスクを通して投影されます。このLSPcHCマスクは、印刷ジョブの光重合反応が層ごとに適切な領域に光を投影、調整する役割を果たします。最後の部分には、特許取得済みのLSPc膜が含まれます。これは、硬化した部分とレジジン液の間に非粘着ゾーンを作成し、樹脂が造形範囲全体にすばやく広がり、各層間の補充を促します。

1...UV ライト配列 2...LSPc® 光層 3...LSPc® HC マスク 4...LSPc® 膜



3Dプリンティングの未来を変える

LSPcテクノロジーは、精度や解像度を損なうことなく、従来のSLAの速度を大幅に改良し、耐久性の高いレジジンプリントが行えます。



直感的インターフェースのソフトウェア

制御用ソフトウェアの操作はシンプルに設計されており、プリント中はプリンター内部のカメラでその様子をモニターすることができます。



Washing & Curing Station

プリントパーツに、洗浄とUV2次硬化をオートマチックに施す装置。わずかな時間で理想の処理を完了させます。

※WashingはIPA(イソプロピルアルコール)を使用します

【製品のお問い合わせ】

株式会社ブレイン

〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町2-2-1 新小倉ビル3F

TEL: 093-512-5980 MAIL: info@brain-design.jp

xGPP Blue



- ・最速プリント用レジン
- ・小さいパーツ向き
- ・薄いシェルパーツ向き

Measurement	Condition	Metric
引張強度	ASTM D638	32.4MPa
引張係数	ASTM D638	2.2GPa
引張破断伸度	ASTM D638	3.2%
曲げ強さ	ASTM D790	-
曲げ弾性率	ASTM D790	-
荷重たわみ温度 (0.45MPa/264PSI)	ASTM D648	59°C
荷重たわみ温度 (1.82MPa/264PSI)	ASTM D648	53°C
ガラス転移点	DMA, E*	93°C
硬さ	ASTM D2240	80

xGPP Translucent



- ・透明性があり、靱性の高いレジン
- ・スナップフィットパーツ向き
- ・流体パーツ向き

Measurement	Condition	Metric
引張強度	ASTM D638	60MPa
引張係数	ASTM D638	2.3GPa
引張破断伸度	ASTM D638	5.5%
曲げ強さ	ASTM D790	-
曲げ弾性率	ASTM D790	-
荷重たわみ温度 (0.45MPa/264PSI)	ASTM D648	61°C
荷重たわみ温度 (1.82MPa/264PSI)	ASTM D648	51°C
ガラス転移点	DMA, E*	-
硬さ	ASTM D2240	88

xGPP Gray



- ・表面が滑らかなレジン
- ・フィギュア向き
- ・歯科モデル向き

Measurement	Condition	Metric
引張強度	ASTM D638	30MPa
引張係数	ASTM D638	2.1GPa
引張破断伸度	ASTM D638	2%
曲げ強さ	ASTM D790	-
曲げ弾性率	ASTM D790	-
荷重たわみ温度 (0.45MPa/264PSI)	ASTM D648	59°C
荷重たわみ温度 (1.82MPa/264PSI)	ASTM D648	53°C
ガラス転移点	DMA, E*	93°C
硬さ	ASTM D2240	84

xABS HT Orange



- ・高強度、高耐熱レジン
- ・機能的パーツ向き
- ・アセンブルパーツ向き

Measurement	Condition	Metric
引張強度	ASTM D638	80MPa
引張係数	ASTM D638	3.2GPa
引張破断伸度	ASTM D638	3.4%
曲げ強さ	ASTM D790	135MPa
曲げ弾性率	ASTM D790	3.25GPa
荷重たわみ温度 (0.45MPa/264PSI)	ASTM D648	-
荷重たわみ温度 (1.82MPa/264PSI)	ASTM D648	120°C
ガラス転移点	DMA, E*	128°C
硬さ	ASTM D2240	90

プリント技術 ・ Continuous LSPc
光源 ・ Structured Light Matrix, 405nm
XY解像度 ・ 75µm
最大造形サイズ(W.D.H)積層 ・ 275×160×400mm
ピッチ ・ 50/100/200µm
接続 ・ RJ-45 Ethernet, WiFi, USB
プリンタサイズ(W.D.H),重量定格 ・ 710×710×1,675mm, 160Kg
電源 ・ 120V/60Hz, 5A, NEMA15-5R
設置環境 ・ 室温15-25°C, 湿度70%以下

プリント ・ 造形サイズ: 275 x 160 x 400 mm
・ 積層ピッチ: 50, 100, 200 micron
・ 光源: Structured Light Matrix, 405 nm
・ XY解像度: 75 micron
・ 接続: Ethernet, Wi-Fi, USB
・ 対応ファイル形式: STL

【製品のお問い合わせ】

株式会社ブレイン

〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町2-2-1 新小倉ビル3F

TEL: 093-512-5980 MAIL: info@brain-design.jp